xxx项目总结报告

| *01编写：（填写项目基本信息* | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | **单板名称** |  |
| **项目经理** |  | **报告人** |  |
| **报告日期** |  |  |  |
| *）#* | | | |

# 项目范围

## 项目组结构

| *02编写：（*介绍项目的人员数目和基本信息， 如：PL, SE, QA和项目组主要成员。 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 角色 | 职责 |
| <1> |  |  |  |
| *）#* | | | |

## 项目基本信息

*03编写：*（简要描述项目所实现的基本功能，提供的接口和技术特点。

*）#*

## 项目平台/工具

*04编写：*（描述项目开发所使用的主要平台和工具，如：

<1> 操作系统：

<2> 仿真工具：

<3> 集成编辑和编译工具：

<4>测试工具、仪器；

<5>配置管理工具：

等。

*）#*

# 项目成果

*05编写：*（项目所取得成果的简要描述。如果没有重大成果，可以参照项目范围部分，说明在项目的范围中描述的内容是否达到目的。可以从以下几方面说明：

<1> 全部实现了产品规格中描述的特性；

<2> 开通了第一个实验局；

<3> 输出了技术共享；

<4> 输出了技术规范；

<5> 输出了专利；

等等。

描述项目的成果，可包括图片或小视频。

*）#*

# 质量目标

| *06编写：（描述项目是否达到在开发计划中定义的质量目标* | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目质量目标 | 目标 | 基线 | 说明 |
| <1> | 进度变化率 <%> | 10% | 20% |  |
| <2> | 第一次投板前缺陷发现密度  <个/KNOC> |  |  |  |
| <3> | 遗留缺陷密度  <个/KNOC> |  |  |  |
| <4> | 生产率  <NOC /人天> |  |  |  |
| <5> | 总缺陷密度  <个/KNOC> |  |  |  |
| <6> | 单板总体设计缺陷发现密度  <个/页> |  |  |  |
| <7> | 单板硬件详细设计缺陷发现密度 <个/页> |  |  |  |
| <8> | 原理图设计缺陷发现密度  <个/KNOC> |  |  |  |
| <9> | PCB设计缺陷发现密度  <个/KNOC> |  |  |  |
| <10> | UT缺陷发现密度  <个/KNOC> |  |  |  |
| <11> | 单板返修率 |  |  |  |
| <12> | 投板二次成功率 |  |  |  |
| *）#* | | | | |

*注：*

*1、KNOC（Kilo-Numboer Of Connetions）, 即千连接数；*

*2、单板返修率，就是出售的一款产品退回来保修的几率；*

# 项目管理总结

*07编写：*（记录项目是怎么管理的，可以从以下几方面描述：

<1> 在项目过程中需求变化是怎么处理的？

<2> 配置管理是如何做的？

<3> 项目计划和项目跟踪是如何做的？

等等。

*）#*

# 风险管理总结

*08编写：*（描述项目从启动到关闭整个过程中主要风险的规避情况，风险管理的经验等等。以便其他项目借鉴共享。

*）#*

# 项目经验、教训

*09编写：*（

描述项目成功的一些主要经验和感受；

描述项目不成功的教训；

*）#*

# 遗留问题

| *10编写：（* | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 问题描述 | 采取措施 | 解决日期 |
| <1> |  |  |  |
| <2> |  |  |  |
| *）#* | | | |

# 对流程改进建议

*11编写：*（*提出项目执行过程中流程可改进的建议。*

*）#*